

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle
Bureau international



(43) Date de la publication internationale
15 janvier 2015 (15.01.2015)

WIPO | PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 2015/003884 A1

(51) Classification internationale des brevets :
H05K 1/03 (2006.01) **G06K 19/077** (2006.01)
H05K 1/18 (2006.01)

(21) Numéro de la demande internationale :
PCT/EP2014/062973

(22) Date de dépôt international :
19 juin 2014 (19.06.2014)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :
13305985.7 10 juillet 2013 (10.07.2013) EP
13306169.7 23 août 2013 (23.08.2013) EP

(71) Déposant : **GEMALTO SA** [FR/FR]; 6, rue de la Verrière, F-92190 Meudon (FR).

(72) Inventeurs : **OTTOBON, Stéphane**; Gemalto SA, Intellectual Property Department, Avenue du Jujubier, ZI Athélia IV, F-13705 La Ciotat (FR). **DOSSETTO, Lucile**; Gemalto SA, Intellectual Property Department, Avenue du Jujubier, ZI Athélia IV, F-13705 La Ciotat (FR). **DEGEILH, Line**; Gemalto SA, Intellectual Property Department, Avenue du Jujubier, ZI Athélia IV, F-13705 La Ciotat (FR).

(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

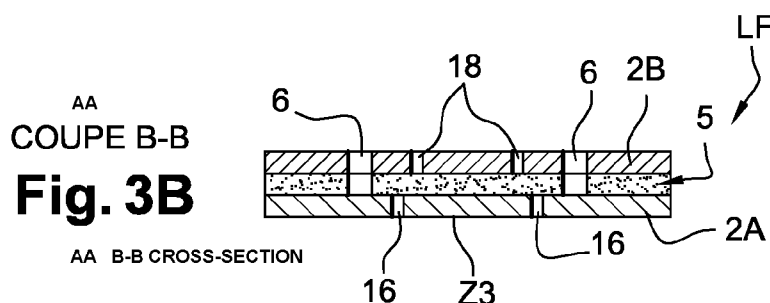
(84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), européen (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée :

— avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))

(54) Title : DIELECTRIC FILMLESS ELECTRONIC MODULE AND METHOD FOR MANUFACTURING SAME

(54) Titre : MODULE ELECTRONIQUE SANS FILM DIELECTRIQUE ET SON PROCEDE DE FABRICATION



(57) Abstract : The invention relates to an electronic module (M) comprising a first metal layer (1) including at least one contact pad (2A) or a conductive pad for connection or interconnection, an insulating layer (5) that is electrically connected to the metal layer via a first surface, a second metal layer (3, 2B, 10, 11, 12) connected to the insulating layer on the opposite surface thereof, a chip location or an electronic chip (7) electrically connected to said at least one contact pad (2A) through openings (6) in the insulating layer, characterized in that the insulating layer is an adhesive.

(57) Abrégé : L'invention concerne un module électronique (M) comportant une première couche métallique (1) comprenant au moins une plage de contact (2A) ou une plage conductrice de connexion ou d'interconnexion, une couche isolante (5) électriquement fixée par une première face à la couche métallique, une seconde couche métallique (3, 2B, 10, 11, 12) fixée à la couche isolante sur sa seconde face opposée, un emplacement de puce ou une puce électronique (7) électriquement connectée à ladite au moins une plage de contact (2A), à travers des ouvertures (6) de la couche isolante, caractérisé en ce que la couche isolante est un adhésif.



WO 2015/003884 A1